

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成29年1月12日(2017.1.12)

【公開番号】特開2015-45094(P2015-45094A)

【公開日】平成27年3月12日(2015.3.12)

【年通号数】公開・登録公報2015-016

【出願番号】特願2014-243538(P2014-243538)

【国際特許分類】

C 2 5 D 3/30 (2006.01)

C 2 5 D 3/60 (2006.01)

C 2 5 D 7/12 (2006.01)

C 2 5 D 5/50 (2006.01)

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

C 2 5 D 3/30

C 2 5 D 3/60

C 2 5 D 7/12

C 2 5 D 5/50

H 0 1 L 21/92 6 0 4 B

【誤訳訂正書】

【提出日】平成28年11月16日(2016.11.16)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 1 1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 1 1】

当該スズ合金組成物は鉛およびシアン化物化合物を含まない。当該スズ合金組成物は、共晶または近共晶であり、かつ多くの従来のスズ合金電気めっき組成物よりも高い電流密度およびめっき速度で堆積されうるスズ合金を堆積することができる。また、当該スズ合金組成物は低発泡性である。さらに、当該スズ合金組成物を用いて堆積された相互接続バンプ(interconnect bumps)は実質的に均一な形態を有し、かつリフロー後に、空隙(voids)がないか、または多くの従来のスズ合金電気めっき組成物よりも低減された密度および空隙の体積を有する相互接続バンプを提供する。相互接続バンプは実質的にノジュールも含まない。